

CONDUCTING PASTE

Patent Number: **JP63174203**

Publication date: **1988-07-18**

Inventor(s): **SUZUKI HITOSHI; YOKOYAMA HIROZO; TSUKADA MINEHARU; OGAWA HIROMI**

Applicant(s): **FUJITSU LTD**

Requested Patent: **JP63174203**

Application Number: **JP19870005411 19870113**

Priority Number(s): **JP19870005411 19870113**

IPC Classification: **H01B1/16; H05K1/09**

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

Data supplied from the **esp@cenet** database - I2

JP-A-63-174203

[Claim 1.]

An electro-conductive paste comprising 100 parts of copper powder, 0.2 to 5 parts of an organic binder, 0 to 1 part of a thixotropy-imparting agent, 12 parts of a solvent having a high boiling point, and 0.5 to 10 parts of amorphous silica.

⑯ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭63-174203

⑬ Int.Cl.

識別記号

府内整理番号

H 01 B 1/16
H 05 K 1/09

8222-5E
A-6679-5F

⑭ 公開 昭和63年(1988)7月18日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

⑮ 発明の名称 導電性ベースト

⑯ 特願 昭62-5411

⑰ 出願 昭62(1987)1月13日

⑱ 発明者 鈴木 均 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内

⑲ 発明者 横山 博三 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内

⑳ 発明者 塚田 峰春 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内

㉑ 発明者 小川 弘美 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内

㉒ 出願人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

㉓ 代理人 弁理士 井桁 貞一

明細書

性粉末単体より30%程度大きくしたものである。

1. 発明の名称

導電性ベースト

2. 特許請求の範囲

1. Cu粉末100部、有機バインダー0.2~5部
ケイソトロビックス1部、シリカ0~1部、
12部、非結晶シリカ0.5~10部から成ることを特徴とする導電性ベースト。

3. 発明の詳細な説明

(概要)

本発明は導電性ベーストにおいて、導電性ベースト焼成後、基板であるセラミックスとの密着性を高めるため添加されているガラスフリットによって起こる印刷性の悪い点と、セラミックスとの焼成収縮率の違いによって起こる一体焼成でのボイドの発生を解決するため、導電ベースト中に表面を疎水性に処理した非結晶シリカあるいは非結晶質のシリカを添加しベーストの粘性のうち、ケイソトロビックス性を向上させ、なおかつ、焼成時、その充てを効果によって収縮率を通常の導電

(産業上の利用分野)

本発明は導電性ベースト組成に関し、特にそのベーストの印刷性の改善と、収縮率の向上に効果のある導電性ベーストに関する。

導電性ベーストは、導体形成後の電気抵抗などの特性も重要なが、プリント基板にセラミックスが実用化されつつある現在、セラミックスへの印刷性や、密着性が重要な特性となる。特に回路基板が多層化に向かいつつあるため、セラミックスグリーンシートへの印刷性の良好なことと、セラミックスとの一体焼成における収縮率の一致が可能な導電性ベーストが必要とされている。

(従来の技術)

従来の導電性ベーストは、導電性のAu、Ag、Cu、Mo、Wなどの金属粉末を主成分に、これに有機ビヒクルを加えベースト状態とし、さらにセラミックスとの密着性を付与させるため、セラミ

ックス焼成温度以下の温度で軟化するガラスを添加している(例えば特願昭56-115039号)。あるいはこの密着性付与剤の補助剤として, Bi_2O_3 , Cr_2O_3 , TiO_2 などの金属酸化物を少量添加している。

〔発明が解決しようとする問題点〕

従来の導電性ペーストでは、ガラスが添加されているため、ガラス粉末と導電性金属粉末のなじみが悪く、ペーストを厚膜技術で印刷する時に流动性が悪く、スクリーンマスクのメッシュの間の抜け性が悪い。このためファインパターンを印刷(印刷)することが出来ない。また、ガラスフリットの非常に少い印刷性の優れた導電性ペーストの場合、印刷性は多少改善されるが、多層にしてセラミックスとの一体焼成を行った際、セラミックスに比べ収縮率が小さく、セラミックス中に亀裂を生じ、割れの原因となるといった問題を生じている。

〔問題を解決するための手段〕

本発明の導電性ペーストは印刷性の改善と、収縮率の増大のため、表面を疎水性基でコーティングした非結晶シリカ(アエロジル)または、非結晶シリカを0.5~5部添加した組成から成る。

〔作用〕

本発明の表面を疎水性基でコーティングした非結晶シリカを添加した導電性ペーストは導電性金属粉末中に分散するシリカ粉末が可塑剤の役目をし、導電性ペーストにせん断応力がかかる際(印刷の際)のペーストの流动性を高め、さらに焼成時にはペースト印刷時に比べシリカが導電性粉末中への充てん効果を發揮し、収縮率を増大させる

〔実施例〕

以下、実施例に従って本発明を更に詳細に説明するが、本発明の技術的範囲をこれらの実施例に限定するものではないことはいうまでもない。

第1実施例

表1に本発明に従った典型的な鋼ペーストの組成(重量部)を示す。

表1. 鋼ペーストの組成

成 分	鋼ペースト		
	1	2	3
本発明	本発明	比 較	
鋼粉末(1~5μm)	100	100	100
疎水性シリカ	3	—	—
非結晶シリカ	—	3	—
硼硅酸ガラス	—	—	8
有機ビヒクル①	12	12	12
副添加物②	2	1	1

- ①: エチルセルロース系バインダーと、ヒマシ油などのチキソトロピー性付与剤を高沸点アルコール系溶剤に混合したもの。
- ②: Bi_2O_3 粉末(径1μm)などの酸化物これらの鋼ペースト①~③は高沸点アルコール系溶剤に、バインダー、チキソトロピー性付与

剤などを混合した有機ビヒクル、密着性を改善する酸化物、あるいは有機チタネットなどを添加し、これに

疎水性シリカ① ニップシール(日本シリカ)

非結晶シリカ②

硼硅酸ガラス③ (コーニング社)
を添加し、これに鋼粉末()製、粒径1μmを混入させ、盤式ボールミル方法で4~8時間混合後、乾燥させ、三本ロールミルで混練することにより製造した。

得られた鋼ペースト①~③の特性について基板として硼硅酸ガラスとアルミナの組合せによるガラス-セラミックス基板を用いて行った実施例によって説明する。

先ず、前記鋼ペースト①~③の硼硅酸ガラス-アルミナ複合系セラミックスグリーンシートへの印刷性を試験した結果を表2に示す。表2に示す比較例及び対照として、
試験結果も示した。

表2. 鋼珪藻ガラス-アルミナ複合系セラミックスグリーンシートへの印刷性

ベースト No.	印刷できる最小 パターン幅(μm)
1	100
2	80
3	150

次に鋼ベーストNo.1～3の収縮率特性を試験した結果を表3に示す。収縮率特性はベーストを溶剤乾燥した後、100℃、1ton/cm²、5分間の加熱加圧成形により、圧粉体(Φ5×10mm)とし、これを1000℃×4hで焼成した時の収縮率を測定した。

表3. 鋼ベーストの収縮率特性

ベーストNo.	収縮率(%)
1	18
2	15
3	10

一方球水性シリカもしくは非結晶シリカの最適添加量は0.5～1.0重量部である。

0.5重量部以上で収縮率改善に効果を示し、一方上限は1.0重量部であるのが好ましく、これを考えると鋼粒子間の空隙にシリカが入り込んで起こる充填効果が失われ、収縮率は逆に低下する。

また0.5重量部以下では充填効果が少も、ほとんど添加しない場合と同等の特性しか得られない。

(発明の効果)

本発明によれば、厚膜の印刷性が改善され、ファインパターンがセラミックス上に描けさらに、焼成時の収縮率がセラミックスに近づくためセラミックスとの一体焼成が容易となる。

代理人弁理士 井桁貞一

